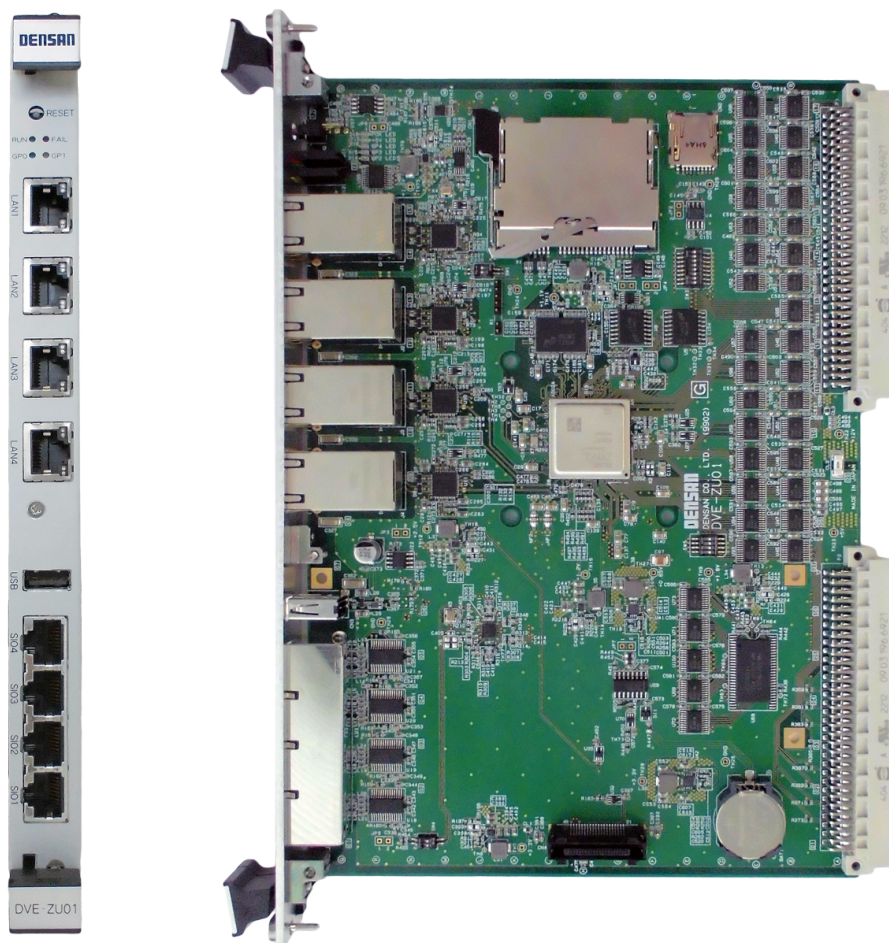


# DVE-ZU01

AMD Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU2CG搭載  
VMEバスボード



## About

Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC搭載モデルは、高性能なMPSoCを搭載し高い拡張性を兼ね備えた省電力なボードコンピュータです。

### 製品特長

最新のZynq UltraScale+ MPSoC採用により長期の製品供給が可能

FPGAにI/Oを構成することで部品点数を減らし部品供給のリスクを軽減

OSはVxWorks、Linux（近日対応）、ITRON系OSは応相談にて各種デバイスドライバをご用意

CPUの発熱量が少ない優れた耐環境性

RS232C 4ポート、Gigabit Ethernet 4ポート装備

**densan**

## 製品仕様

## DVE-ZU01

項目	内容		
CPU	デバイス	XCZU2CG-1SFVC784E(AMD製)	
	コア	デュアルARM Cortex-A53, デュアルARM Cortex-R5F	
	L1キャッシュ	Iキャッシュ	32KB(with Parity)
		Dキャッシュ	32KB(with ECC)
	L2キャッシュ	1MB(with ECC)	
	動作クロック	1GHz(1005MHz)	
	DDR転送速度	1600MT/s	
	備考	デュアルARM Coretex-R5Fは未使用のため省略	
LPDDR4	メモリ容量	2GB(4GB対応可)	
	データバス幅	32bit	
VME	仕様	VMEbus Specification Revision C.3準拠	
		VMEbus マスタ・スレーブ	
		システムコントローラ	
		割り込みハンドラ機能	
		A32/A24/A16 D32/D16/D8(E0)	
		バスサイジング機能	
		バイトスワップ機能	
USB	仕様	USB 2.0 ホスト	
	供給電源	+5.0V、0.5A	
QSPI Flash	メモリ容量	64MB(32MB x2)	
	備考	プライマリブートデバイスとして使用	
microSD I/F	規格	SD 2.0	
	容量	SDHC	
	転送速度	ハイスピード	
CFast I/F	仕様	SATA Gen1(1.5Gbps)	
Gigabit Ethernet	ポート数	4(2ポートはRGMII接続、2ポートはSGMII接続)	
RS232C	対応信号	TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DCD、DCR	
	コネクタ	HRS製TM11R-5L-3232(40)(HRS製) RJ45 4連	
RTC	バックアップ	リチウム電池 BR2032:190mAh(SRAMと共通)	

## 製品仕様

## DVE-ZU01

項目	内容	
SRAM	メモリ容量	512KB
	データバス幅	16bit
	バックアップ	リチウム電池 BR2032:190mAh(RTCと共通)
	備考	MRAM/FRAM対応可
スイッチ	機能	リセットスイッチ、汎用8bitDIPスイッチ
LED	機能	RUN(緑)、FAIL(赤)、GP1(緑)、GP2(黄色)
温度センサ	観測点	LAN1、LAN2、CPUの温度監視
電源	電圧	+5V±5%
	消費電流	T.B.D
環境仕様	動作温度	0~60°C
	動作湿度	25%~95%(結露なきこと)
	保存温度	-20~70°C
	保存湿度	25%~95%(結露なきこと)
	空冷	1.5m/s以上
	耐振動	ClassV1 PSD=0.04G <sup>2</sup> /Hz
	耐衝撃	20G、11ms 正弦半波X,Y,Z方向
機械的仕様	外形	6U シングルスロット幅
	基板サイズ	233.35mm x 160.00mm x 20.32mm
	重量	T.B.D.
	基板材質	FR-4
安全性	難燃性	UL94V Class V-0グレードのPCBを使用
	備考	電源にはヒューズを挿入
その他	RoHS指令	すべての部材でRoHS指令適合品を使用

**株式会社 電産**

**東京営業所**

〒168-0074 東京都杉並区上高井戸1-25-16

TEL:03-3329-3871 FAX:03-3329-9266

**大阪営業所**

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-23-16

TEL:06-6770-9690 FAX:06-6770-9698

<https://www.densan.co.jp>

\*記載されている会社名、商標名は各社の商標または登録商標です。

\*この資料は2023年11月の発行です。なお、仕様その他は予告なしに変更することがございます。

**densan**